

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



香港聯交所股票代號：1347

新聞稿

華虹半導體二零二一年第二季度業績公佈

所有貨幣以美元列帳，除非特別指明。

本合併財務報告系依香港財務報告準則編製。

中國香港 — 2021年8月12日 — 全球領先的特色工藝純晶圓代工廠華虹半導體有限公司（香港聯交所股票代號：1347）（「本公司」）於今日公佈截至二零二一年六月三十日止三個月的綜合經營業績。

二零二一年第二季度主要財務指標（未經審核）

- 銷售收入再創歷史新高，達 3.461 億美元，同比上升 53.6%，環比上升 13.5%。
- 毛利率 24.8%，同比下降 1.2 個百分點，環比上升 1.1 個百分點。
- 期內溢利 3,720 萬美元，上年同期為 130 萬美元，上季度為 2,090 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,410 萬美元，上年同期為 1,780 萬美元，上季度為 3,310 萬美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元，上年同期為 0.014 美元，上季度為 0.025 美元。
- 淨資產收益率（年化）6.8%，同比上升 3.6 個百分點，環比上升 1.6 個百分點。

二零二一年第三季度指引

- 我們預計銷售收入約 4.10 億美元左右。
- 我們預計毛利率約在 25%至 27%之間。

總裁致辭

公司總裁兼執行董事唐均君先生對二零二一年第二季度業績評論道：

“2021 年第二季度對華虹半導體來說又是再創新高的一個季度，單季營收達到前所未有的 3.461 億美元，同比增長 53.6%，環比增長 13.5%。得益於國內市場不斷增長的需求、銷售數量和單價的雙雙顯著提升，MCU 微控制器、射頻、電源管理、標準式閃存以及超級結等市場需求仍然十分強勁，為公司持續、穩定的發展提供了堅實基礎。第二季度公司 8”+12”平臺整體毛利率為 24.8%，同比下降 1.2 個百分點，主要由於 12 英寸平臺銷售份額的增長及伴隨著大量折舊的產生。令人可喜的是：因銷售單價上升、產能利用率創新高，環比提高 1.1 個百分點。二季度公司出貨大大增加。盈利能力也大幅提升，實現淨利潤 3,720 萬美元，同比增加 2,848.3%，環比增加 77.7%。”

“對於三條 8 英寸生產線來說，本季度也是有史以來最好的一個季度。8 英寸平臺營業收入創下 2.62 億美元的歷史最高。得益於平均銷售價格的提高和生產線效能提升，8 英寸毛利率從 2021 年第一季度的 27.3% 提高到 31.6%。貢獻淨利潤 5,130 萬美元，占總收入的 19.6%。我們將把握機遇，繼續做優 8 英寸生產線的工藝平臺，8 英寸生產線效益前景仍然看好。”

“華虹無錫 12 英寸生產線第二季度營收達到 0.84 億美元，同比增長 786.8%，環比增加 54.0%，息稅折攤前利潤 2,990 萬美元，較上季度增長 208.3%。有鑒於華虹先進特色工藝的超強市場活力，嵌入式閃存、模擬電路以及功率器件等工藝平臺，迅速在 12 英寸生產線上研發成功，客戶產品快速導入，支撐了生產線產能增長。產品結構佈局合理，與市場需求高度契合。截至今年 5 月份，12 英寸生產線月產能已達到 4.8 萬片，產能利用滿載。我們加強與供應商密切合作，確保擴產上量計畫穩步推進。我們將穩步實現於今年年底達到 6.5 萬片的月生產能力。為了滿足旺盛的市場需求，公司還將繼續加大投入，進一步擴大產能，不斷優化工藝佈局，與產業鏈一起發展壯大。”

“隨著上海三條 8 英寸生產線的持續優化和 12 英寸生產線的迅速擴張，華虹半導體的發展已步入穩定、有質量的發展新階段。作為半導體供應鏈中至關重要的代工生產環節，公司將繼續堅定不移地執行 8”+12”齊頭並進、協同發力的先進“特色 IC + Power Discrete”戰略，全力以赴以最優最快最穩的發展節奏支援研發創新，為客戶提供全面優質的技術服務，為緩解全球半導體供應短缺作出貢獻。”

電話會議公告

日期：二零二一年八月十二日（星期四）

時間：下午 04:00（上海 / 香港）
上午 04:00（紐約，2021 年 8 月 12 日，星期四）

發言人：唐均君，總裁兼執行董事
王鼎，執行副總裁兼首席財務官

廣播：該電話會議將於下述網站進行語音及幻燈片直播：
http://www.huahonggrace.com/html/investor_webcast.php 或
<https://edge.media-server.com/mmc/p/hxwtgzrr>

(注：需要註冊才能訪問網絡直播)

電話直撥：請在會議前使用以下連結先進行註冊。註冊後，您將收到確認郵件獲得撥入號碼、密碼和唯一的註冊人 ID。

<http://apac.directeventreg.com/registration/event/6854478>

重要提示：在會議開始前，您需要使用確認郵件中提供的密碼和註冊人 ID 才能進入會議。請在註冊後，注意查收並保存確認郵件。出於安全原因，請不要與任何人共用您的註冊人 ID。

電話會議登入名：6854478

直播約 24 小時後，您可於 12 個月內在 http://www.huahonggrace.com/s/investor_webcast.php 網頁上，重複收聽會議。

關於華虹半導體

華虹半導體有限公司（「華虹半導體」，股份代號：1347.HK）（「本公司」）是全球領先的特色工藝純晶圓代工企業，專注於嵌入式非易失性存儲器、功率器件、模擬及電源管理和邏輯及射頻等「8 英寸 + 12 英寸」特色工藝技術的持續創新，先進「特色 IC + Power Discrete」強大的工藝技術平台有力支持物聯網等新興領域應用，其卓越的質量管理體系亦滿足汽車電子芯片生產的嚴苛要求。本公司是華虹集團的一員，而華虹集團是以集成電路製造為主業，擁有「8 英寸 + 12 英寸」生產線先進工藝技術的企業集團。

本公司在上海金橋和張江建有三座 8 英寸晶圓廠（華虹一廠、二廠及三廠），月產能約 18 萬片。同時在無錫高新技術產業開發區內有一座月產能 4.8 萬片的 12 英寸晶圓廠（華虹七廠），不僅是中國大陸領先的 12 英寸特色工藝生產線，亦為全球第一條 12 英寸功率器件代工生產線。

如欲取得更多公司相關資料，請瀏覽：www.huahonggrace.com。

經營業績概要
(以千美元計，每股盈利和營運數據除外)

	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售收入	346,110	225,350	304,843	53.6 %	13.5 %
銷售成本	(260,440)	(166,840)	(232,685)	56.1 %	11.9 %
毛利	85,670	58,510	72,158	46.4 %	18.7 %
毛利率	24.8 %	26.0 %	23.7 %	(1.2)	1.1
經營開支	(45,905)	(62,512)	(59,502)	(26.6)%	(22.9)%
其他收入淨額	11,896	12,000	7,121	(0.9)%	67.1 %
稅前溢利	51,661	7,998	19,777	545.9 %	161.2 %
所得稅(開支)/抵免	(14,483)	(6,737)	1,148	115.0 %	(1,361.6)%
期內溢利	37,178	1,261	20,925	2,848.3 %	77.7 %
淨利潤率	10.7 %	0.6 %	6.9 %	10.1	3.8
以下各方應佔利潤:					
母公司擁有人	44,082	17,826	33,059	147.3 %	33.3 %
非控股權益	(6,904)	(16,565)	(12,134)	(58.3)%	(43.1)%
持有人應佔每股盈利					
基本	0.034	0.014	0.025	142.9 %	36.0 %
攤薄	0.033	0.014	0.025	135.7 %	32.0 %
付運晶圓(折合 8 吋仟片)	730	523	669	39.6 %	9.1 %
產能利用率 ¹	109.5 %	93.4 %	104.2 %	16.1	5.3
淨資產收益率 ²	6.8 %	3.2 %	5.2 %	3.6	1.6

二零二一年第二季度

- 銷售收入再創歷史新高，達 3.461 億美元，同比上升 53.6%，環比上升 13.5%。
- 銷售成本 2.604 億美元，同比上升 56.1%，環比上升 11.9%，主要由於晶圓銷售量及折舊成本上升。
- 毛利率 24.8%，同比下降 1.2 個百分點，主要由於折舊成本上升，部分被平均銷售價格上漲及產能利用率提升所抵消，環比上升 1.1 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲及產能利用率提升。
- 經營開支 4,590 萬美元，同比下降 26.6%，環比下降 22.9%，主要由於研發活動的政府補助增加。
- 其他收入淨額 1,190 萬美元，同比持平。其他收入淨額環比上升 67.1%，主要由於本季度為外幣匯兌收益而上季度為外幣匯兌損失。
- 所得稅開支 1,450 萬美元，上年同期為 670 萬美元，主要由於應課稅利潤增加，上季度為所得稅抵免 110 萬美元，主要由於上季度轉回上年度計提的代扣代繳股息稅。
- 期內溢利 3,720 萬美元，上年同期為 130 萬美元，上季度為 2,090 萬美元。
- 母公司擁有人應佔溢利 4,410 萬美元，上年同期為 1,780 萬美元，上季度為 3,310 萬美元。
- 基本每股盈利 0.034 美元，上年同期為 0.014 美元，上季度為 0.025 美元。
- 淨資產收益率（年化）6.8%，同比上升 3.6 個百分點，環比上升 1.6 個百分點。

¹產能利用率按平均月約當產量除以總估計月產能計算。

²母公司擁有人應佔利潤 / 加權平均母公司擁有人應佔淨資產。

分部經營業績
(以千美元計，營運數據除外)

	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
華虹 8 吋					
銷售收入	261,975	215,862	250,196	21.4 %	4.7 %
毛利	82,862	59,711	68,194	38.8 %	21.5 %
毛利率	31.6 %	27.7 %	27.3 %	3.9	4.3
經營開支	(20,835)	(26,342)	(32,528)	(20.9)%	(35.9)%
稅前溢利	65,751	41,804	44,540	57.3 %	47.6 %
息稅折舊及攤銷前利潤	103,994	74,371	82,883	39.8 %	25.5 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	39.7 %	34.5 %	33.1 %	5.2	6.6
付運晶圓(8 吋仔片)	546	501	541	9.0 %	0.9 %
華虹無錫					
銷售收入	84,135	9,488	54,647	786.8 %	54.0 %
毛利	2,808	(1,201)	3,964	(333.8)%	(29.2)%
毛利率	3.3 %	(12.7)%	7.3 %	16.0	(4.0)
經營開支	(25,070)	(36,170)	(26,974)	(30.7)%	(7.1)%
稅前溢利	(14,090)	(33,806)	(24,763)	(58.3)%	(43.1)%
息稅折舊及攤銷前利潤	29,864	(18,493)	9,688	(261.5)%	208.3 %
息稅折舊及攤銷前利潤率	35.5 %	(194.9)%	17.7 %	230.4	17.8
付運晶圓(折合 8 吋仔片)	184	22	128	736.4 %	43.8 %

華虹 8 吋

- 銷售收入創歷史新高，達 2.620 億美元，同比上升 21.4%，環比上升 4.7%。
- 毛利率 31.6%，同比上升 3.9 個百分點，環比上升 4.3 個百分點，主要得益於平均銷售價格上漲及產能利用率提升。
- 經營開支 2,080 萬美元，同比下降 20.9%，環比下降 35.9%，主要由於分攤成本至華虹無錫。
- 稅前溢利 6,580 萬美元，同比上升 57.3%，環比上升 47.6%。

華虹無錫

- 銷售收入 8,410 萬美元，上年同期為 950 萬美元，上季度為 5,460 萬美元。
- 經營開支 2,510 萬美元，同比下降 30.7%，環比下降 7.1%，主要由於研發活動的政府補助增加，部分被服務費用上升所抵消。
- 息稅折舊及攤銷前利潤 2,990 萬美元，上年同期為虧損 1,850 萬美元，上季度為盈利 970 萬美元。

銷售收入分析

按類別劃分的 銷售收入	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
晶圓	331,384	95.7 %	216,291	96.0 %	115,093	53.2 %
其他	14,726	4.3 %	9,059	4.0 %	5,667	62.6 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度 95.7% 的銷售收入來源於半導體晶圓的直接銷售。

銷售收入分析

按晶圓尺寸劃分的 銷售收入	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
8 吋晶圓	261,975	75.7 %	215,862	95.8 %	46,113	21.4 %
12 吋晶圓	84,135	24.3 %	9,488	4.2 %	74,647	786.8 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度來自於 8 吋晶圓和 12 吋晶圓的銷售收入分別為 2.620 億美元及 8,410 萬美元。

銷售收入分析

按地域劃分的 銷售收入	二零二一年	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
中國 ³	255,218	73.8 %	137,558	61.0 %	117,660	85.5 %
亞洲 ⁴	38,515	11.1 %	28,560	12.7 %	9,955	34.9 %
美國 ⁵	29,528	8.5 %	33,758	15.0 %	(4,230)	(12.5)%
歐洲	16,317	4.7 %	19,089	8.5 %	(2,772)	(14.5)%
日本 ⁶	6,532	1.9 %	6,385	2.8 %	147	2.3 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度來自於中國的銷售收入 2.552 億美元，占銷售收入總額的 73.8%，同比增長 85.5%，主要得益於各個技術平台產品的需求增加。
- 本季度來自於亞洲的銷售收入 3,850 萬美元，同比增長 34.9%，主要得益於 MCU 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度來自於美國的銷售收入 2,950 萬美元，同比減少 12.5%，主要由於 MCU 產品的出貨量減少。
- 本季度來自於歐洲的銷售收入 1,630 萬美元，同比減少 14.5%，主要由於智能卡芯片的出貨量減少。
- 本季度來自於日本的銷售收入 650 萬美元，同比基本持平。

³包括香港。

⁴不包括中國及日本。

⁵包括於 2020 年由一家總部位於歐洲的公司所收購的一家主要美國客戶。

⁶包括於 2013 年由一家總部位於美國的公司所收購的一家主要日本客戶。

銷售收入分析

按技術平台劃分的 銷售收入	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
嵌入式非易失性存儲器	103,576	29.9 %	76,866	34.1 %	26,710	34.7 %
獨立非易失性存儲器	18,325	5.3 %	3,155	1.4 %	15,170	480.8 %
分立器件	119,754	34.6 %	86,779	38.5 %	32,975	38.0 %
邏輯及射頻	57,016	16.5 %	26,712	11.9 %	30,304	113.4 %
模擬與電源管理	46,945	13.6 %	31,555	14.0 %	15,390	48.8 %
其他	494	0.1 %	283	0.1 %	211	74.6 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度嵌入式非易失性存儲器銷售收入 1.036 億美元，同比增長 34.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度獨立非易失性存儲器銷售收入 1,830 萬美元，同比增長 480.8%，主要得益於 NOR flash 產品的需求增加。
- 本季度分立器件銷售收入 1.198 億美元，同比增長 38.0%，主要得益於通用 MOSFET、超級結及 IGBT 產品的需求增加。
- 本季度邏輯及射頻銷售收入 5,700 萬美元，同比增長 113.4%，大部分得益於 CIS 和邏輯產品的需求增加。
- 本季度模擬與電源管理銷售收入 4,690 萬美元，同比增長 48.8%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。

銷售收入分析

按工藝技術節點劃分的銷售收入	二零二一年	二零二一年	二零二零年	二零二零年	同比	同比
	第二季度	第二季度	第二季度	第二季度		
	仟美元	%	仟美元	%	仟美元	%
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)		
55nm 及 65nm	30,570	8.8 %	915	0.4 %	29,655	3,241.0 %
90nm 及 95nm	49,256	14.2 %	21,667	9.6 %	27,589	127.3 %
0.11 μ m 及 0.13 μ m	70,772	20.4 %	53,740	23.9 %	17,032	31.7 %
0.15 μ m 及 0.18 μ m	36,881	10.7 %	33,971	15.1 %	2,910	8.6 %
0.25 μ m	6,956	2.0 %	4,009	1.8 %	2,947	73.5 %
0.35 μ m 及以上	151,675	43.9 %	111,048	49.2 %	40,627	36.6 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度 55nm 及 65nm 工藝技術節點的銷售收入 3,060 萬美元，同比增長 3,241.0%，主要得益於 NOR flash、CIS 及邏輯產品的需求增加。
- 本季度 90nm 及 95nm 工藝技術節點的銷售收入 4,930 萬美元，同比增長 127.3%，主要得益於 CIS、其他電源管理、MCU 及智能卡芯片的需求增加。
- 本季度 0.11 μ m 及 0.13 μ m 工藝技術節點的銷售收入 7,080 萬美元，同比增長 31.7%，主要得益於 MCU 產品的需求增加。
- 本季度 0.15 μ m 及 0.18 μ m 工藝技術節點的銷售收入 3,690 萬美元，同比增長 8.6%，主要得益於其他電源管理產品的需求增加。
- 本季度 0.25 μ m 工藝技術節點的銷售收入 700 萬美元，同比增長 73.5%，主要得益於邏輯產品的需求增加。
- 本季度 0.35 μ m 及以上工藝技術節點的銷售收入 1.517 億美元，同比增長 36.6%，主要得益於通用 MOSFET、超級結、IGBT 及 LED 照明產品的需求增加。

銷售收入分析

按終端市場分佈劃分的銷售收入	二零二一年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二一年 第二季度 % (未經審核)	二零二零年 第二季度 仟美元 (未經審核)	二零二零年 第二季度 % (未經審核)	同比 仟美元	同比 %
電子消費品	220,519	63.7 %	133,727	59.3 %	86,792	64.9 %
工業及汽車	66,107	19.1 %	56,046	24.9 %	10,061	18.0 %
通訊	48,034	13.9 %	27,455	12.2 %	20,579	75.0 %
計算機	11,450	3.3 %	8,122	3.6 %	3,328	41.0 %
銷售收入總額	346,110	100.0 %	225,350	100.0 %	120,760	53.6 %

- 本季度電子消費品作為我們的第一大終端市場，貢獻銷售收入 2.205 億美元，占銷售收入總額的 63.7%，同比增長 64.9%，主要得益於 MCU、NOR flash、其他電源管理、超級結、邏輯及通用 MOSFET 產品的需求增加。
- 本季度工業及汽車產品銷售收入 6,610 萬美元，同比增長 18.0%，主要得益於 IGBT 及 MCU 產品的需求增加。
- 本季度通訊產品銷售收入 4,800 萬美元，同比增長 75.0%，主要得益於 CIS 產品的需求增加。
- 本季度計算機產品銷售收入 1,150 萬美元，同比增長 41.0%，主要得益於 MCU 及通用 MOSFET 產品的需求增加。

產能⁷及產能利用率

晶圓廠(仟片晶圓每月)	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)
1 號晶圓廠 (200mm)	65	65	65
2 號晶圓廠 (200mm)	60	60	60
3 號晶圓廠 (200mm)	53	53	53
7 號晶圓廠 (300mm)	40	10	28
合計折合 8 吋產能	268	201	241
產能利用率 (200mm)	112.1%	100.4%	104.3%
產能利用率 (300mm)	104.1%	38.3%	103.8%
總體產能利用率	109.5%	93.4%	104.2%

- 本季度末月產能達 268,000 片 8 吋等值晶圓。總體產能利用率為 109.5%，環比上升 5.3 個百分點。

⁷ 期末月產能，且為比較目的，以 30 天作為計算基礎。

付運晶圓

折合 8 吋矽片晶圓	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
付運晶圓	730	523	669	39.6 %	9.1 %

- 本季度付運晶圓 730,000 片，同比增加 39.6%，環比增加 9.1%。

經營開支分析

以千美元計	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
銷售及分銷費用	1,988	1,925	2,620	3.3 %	(24.1)%
管理費用 ⁸	43,917	60,587	56,882	(27.5)%	(22.8)%
經營開支	45,905	62,512	59,502	(26.6)%	(22.9)%

- 經營開支 4,590 萬美元，同比下降 26.6%，環比下降 22.9%，主要由於研發活動的政府補助增加。

其他收入淨額

以千美元計	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
租金收入	3,544	3,071	3,680	15.4 %	(3.7)%
利息收入	3,547	2,960	3,037	19.8 %	16.8 %
以公允價值計量且變動計入當期損益 的金融資產之公允價值變動收益	-	1,658	-	(100.0)%	-
匯兌收益/(損失)	6,050	(361)	(269)	(1,775.9)%	(2,349.1)%
分佔聯營公司溢利	1,424	4,362	1,512	(67.4)%	(5.8)%
財務費用	(3,418)	(301)	(1,636)	1,035.5 %	108.9 %
政府補貼	376	453	544	(17.0)%	(30.9)%
其他	373	158	253	136.1 %	47.4 %
其他收入淨額	11,896	12,000	7,121	(0.9)%	67.1 %

- 其他收入淨額 1,190 萬美元，同比持平。其他收入淨額環比上升 67.1%，主要由於本季度為外幣匯兌收益而上季度為外幣匯兌損失。

⁸管理費用包括確認為研發開支抵減項目的政府補助。

現金流量分析

以千美元計	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二零年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)	同比	環比
經營活動所得現金流量淨額	99,127	101,847	60,831	(2.7)%	63.0%
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(134,719)	81,493	(167,528)	(265.3)%	(19.6)%
融資活動所得/(用)現金流量淨額	40,584	(3,230)	146,928	(1,356.5)%	(72.4)%
外匯匯率變動影響淨額	8,024	545	(1,511)	1,372.1%	(631.0)%
現金及現金等價物變動影響淨額	13,016	180,655	38,720	(92.8)%	(66.4)%

- 本季度經營活動所得現金流量淨額 9,910 萬美元，同比下降 2.7%，主要由於材料和人工費用的支出增加，及收到增值稅退稅款減少，大部分被客户信用管理提升帶來的客戶收款增加所抵消。
- 投資活動所用現金流量淨額 1.347 億美元，其中固定資產及無形資產投資支出 1.365 億美元，部分被利息收入 180 萬美元所抵消。
- 融資活動所得現金流量淨額 4,060 萬美元，其中提取銀行借款 4,760 萬美元和發行股份收到 10 萬美元，部分被支付銀行借款利息 400 萬美元、償還銀行貸款本金 230 萬美元及租賃負債支出 80 萬美元所抵消。

資本結構

以千美元計	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)
資產總額	4,990,981	4,682,434
負債總額	1,539,407	1,326,917
所有者權益總額	3,451,574	3,355,517
資產負債率 ⁹	30.8%	28.3%

資本開支

以千美元計	二零二一年 第二季度 (未經審核)	二零二一年 第一季度 (未經審核)
華虹 8 吋	17,439	24,275
華虹無錫	119,096	143,082
合計	136,535	167,357

- 本季度資本開支 1.365 億美元，其中 1.191 億美元用於華虹無錫。

⁹ 資產負債率=負債總額/資產總額。

流動性分析

以千美元計	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)
發展中物業	107,865	106,040
存貨	355,881	283,764
貿易應收款項及應收票據	108,358	127,613
預付款項、其他應收款項及其他資產	61,448	29,280
應收關聯方款項	6,253	7,220
已凍結存款及定期存款	362	356
現金及現金等價物	974,522	961,506
流動資產總額	1,614,689	1,515,779
貿易應付款項	147,074	124,799
其他應付款項及暫估費用	491,089	346,232
計息銀行借款	138,627	90,959
租賃負債	2,010	1,884
政府補助	76,611	67,609
應付關聯方款項	18,723	23,469
應付所得稅	22,165	31,432
流動負債總額	896,299	686,384
淨營運資金	718,390	829,395
速動比率	1.4x	1.6x
流動比率	1.8x	2.2x
貿易應收款項及應收票據周轉天數	31	37
存貨周轉天數	111	99

- 存貨由上季度末的 2.838 億美元上升至本季度末的 3.559 億美元，主要由於客戶需求增加。
- 貿易應收款項及應收票據由上季度末的 1.276 億美元下降至本季度末的 1.084 億美元，主要得益於客戶信用管理的提升。
- 預付款項、其他應收款項及其他資產由上季度末的 2,930 萬美元上升至本季度末的 6,140 萬美元，主要由於應收增值稅退稅款增加。
- 其他應付款項及暫估費用由上季度末的 3.462 億美元上升至本季度末的 4.911 億美元，主要由於應付資本性開支及客戶預收款項增加。
- 計息銀行借款由上季度末的 9,100 萬美元上升至本季度末的 1.386 億美元，主要由於本季度提取銀行借款。
- 應付所得稅由上季度末的 3,140 萬美元下降至本季度末的 2,220 萬美元，主要由於支付 2020 年度所得稅，部分被 2021 上半年計提應付所得稅所抵消。
- 淨營運資金本季度末 7.184 億美元，流動比率 1.8。
- 貿易應收款項及應收票據周轉天數由上季度的 37 天縮短至 31 天。
- 存貨周轉天數 111 天。

上述公佈詳情請參閱華虹半導體網站 www.huahonggrace.com。

華虹半導體有限公司
簡明損益表(以千美元計,每股盈利和股數除外)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)
銷售收入	346,110	225,350	304,843
銷售成本	(260,440)	(166,840)	(232,685)
毛利	85,670	58,510	72,158
其他收入及收益	13,898	8,303	7,604
銷售及分銷費用	(1,988)	(1,925)	(2,620)
管理費用	(43,917)	(60,587)	(56,882)
其他費用	(8)	(364)	(359)
財務費用	(3,418)	(301)	(1,636)
分佔聯營公司溢利	1,424	4,362	1,512
稅前溢利	51,661	7,998	19,777
所得稅(開支)/抵免	(14,483)	(6,737)	1,148
期內溢利	37,178	1,261	20,925
以下各方應佔利潤			
母公司擁有人	44,082	17,826	33,059
非控股權益	(6,904)	(16,565)	(12,134)
持有人應佔每股盈利			
基本	0.034	0.014	0.025
攤薄	0.033	0.014	0.025
用於計算持有人應佔每股基本盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,300,192,217	1,291,439,564	1,299,428,463
用於計算持有人應佔每股攤薄盈利的期內已發行普通股加權平均數	1,325,014,217	1,300,881,564	1,325,196,463

華虹半導體有限公司
簡明綜合財務狀況表(以千美元計)

	截至		
	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)
資產			
非流動資產			
物業、廠房及設備	2,710,002	2,498,485	1,790,860
投資物業	182,287	179,202	166,154
使用權資產	76,997	77,050	75,810
無形資產	35,784	36,841	32,201
於聯營公司的投資	110,699	107,436	79,335
以公允價值計量且變動計入其他綜合收益的權益工具	232,575	228,639	204,658
長期預付款項	17,407	29,447	42,100
應收關聯方款項	40	17	1,994
遞延稅項資產	10,501	9,538	8,160
非流動資產總額	3,376,292	3,166,655	2,401,272
流動資產			
發展中物業	107,865	106,040	-
存貨	355,881	283,764	176,856
貿易應收款項及應收票據	108,358	127,613	135,518
預付款項、其他應收款項及其他資產	61,448	29,280	66,174
應收關聯方款項	6,253	7,220	11,588
以公允價值計量且變動計入當期損益的金融資產	-	-	84,759
已凍結存款及定期存款	362	356	766
現金及現金等價物	974,522	961,506	698,957
流動資產總額	1,614,689	1,515,779	1,174,618
流動負債			
貿易應付款項	147,074	124,799	92,607
其他應付款項及暫估費用	491,089	346,232	318,489
計息銀行借款	138,627	90,959	4,238
租賃負債	2,010	1,884	3,757
政府補助	76,611	67,609	40,105
應付關聯方款項	18,723	23,469	13,467
應付所得稅	22,165	31,432	14,292
流動負債總額	896,299	686,384	486,955
流動資產淨額	718,390	829,395	687,663
總資產減流動負債	4,094,682	3,996,050	3,088,935
非流動負債			
計息銀行借款	616,254	618,261	19,069
租賃負債	16,463	16,689	16,889
遞延稅項負債	10,391	5,583	3,194
非流動負債總額	643,108	640,533	39,152
淨資產	3,451,574	3,355,517	3,049,783
權益和負債權益			
股本	1,984,207	1,984,004	1,971,748
儲備	652,280	563,599	286,489
本公司擁有人應佔權益	2,636,487	2,547,603	2,258,237
非控股權益	815,087	807,914	791,546
權益總額	3,451,574	3,355,517	3,049,783

華虹半導體有限公司
簡明綜合現金流量表(以千美元計)

	截至以下日期止三個月		
	於六月三十日 二零二一年 (未經審核)	於六月三十日 二零二零年 (未經審核)	於三月三十一日 二零二一年 (未經審核)
經營活動所得現金流量：			
稅前溢利	51,661	7,998	19,777
折舊及攤銷	78,786	47,579	71,158
應佔聯營公司溢利	(1,424)	(4,362)	(1,512)
營運資金的變動及其它	(29,896)	50,632	(28,592)
經營活動所得現金流量淨額	99,127	101,847	60,831
投資活動所(用)/得現金流量：			
購買物業、廠房、設備及無形資產項目	(136,535)	(178,073)	(167,357)
投資聯營公司	-	-	(1,484)
其他投資活動所得現金流量	1,816	259,566	1,313
投資活動所(用)/得現金流量淨額	(134,719)	81,493	(167,528)
融資活動所得/(用)現金流量：			
提取銀行貸款	47,590	-	143,208
發行股份所得收益	151	17	6,498
償還銀行貸款	(2,322)	(2,119)	-
償還租賃負債	(827)	(1,050)	(2,709)
已付利息	(4,008)	(78)	(69)
融資活動所得/(用)現金流量淨額	40,584	(3,230)	146,928
現金及現金等價物增加淨額	4,992	180,110	40,231
外匯匯率變動影響淨額	8,024	545	(1,511)
期初現金及現金等價物	961,506	518,302	922,786
期末現金及現金等價物	974,522	698,957	961,506

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事

張素心(董事長)

唐均君(總裁)

非執行董事

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事

張祖同

王桂壘太平紳士

葉龍蜚

承董事會命

華虹半導體有限公司

張素心

董事長兼執行董事

中國 香港

二零二一年八月十二日